



揚博科技股份有限公司 Ampoc Far-East Co., Ltd

2023/09/27
法說會



CONTENTS

- 公司簡介
 - 自製設備產品介紹與展望
- 公司現況
 - 代理業務產業應用與展望
- 財務資訊

01

公司簡介



創立於
1976年

資本額
11.4億

營業額
34.48億

員工人數
340人

1980-1990年

- 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。
- 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。

2001-2010年

- 申請公司名稱變更為「揚博科技股份有限公司」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。
- 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 2493。

2021-迄今

- 企業永續經營，成立ESG專案小組。
- 發展ECO System熱交換系統。

1976年-草創

- 購入台北市松德路171號17樓為揚博科技企業總部。
- 獲准成為公開發行公司。
- 合併台北化工機械股份有限公司。

1991-2000年

- 開發Ampoc Wing，正式交貨予客戶投入生產。
- 董事會通過香港設立子公司。
- 透過香港子公司投資揚博上海分公司。

2011-2020年

02

公司現況



~揚博科技以服務電子產業為職志，積極扮演資訊電子產業之橋樑~



董事長：蘇勝義



- 2大事業處**
- 製造管理處
 - 營業管理處



- 4大核心**
- 高階製造
 - 高科技研發
 - 半導體先進製程
 - 節能減碳



- 9大思維**
- 品質第一
 - 創新求進
 - 專業導向
 - 流程改善
 - 全員經營
 - 產銷國際
 - 服務至上
 - 社會責任
 - 永續經營



- 3大技術**
- Ampoc Wing
 - Ampoc ECO
 - Ampoc 5A

03

財務資訊



最近年度合併綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	110年度	111年度	112年上半年度
營業收入		2,938,974	3,448,384	1,640,864
營業毛利		778,114	1,098,413	617,516
毛利率(%)		26.48	31.85	37.63
營業利益		453,574	756,369	415,770
稅後淨利		343,298	592,400	343,130
每股盈餘(元)		3.00	5.18	3.00



最近年度合併資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	110年	111年	112年上半年
流動資產		3,145,641	3,992,366	4,101,393
非流動資產		695,569	633,581	614,516
資產總額		3,841,210	4,625,947	4,715,909
流動負債		1,282,260	1,762,805	1,976,926
非流動負債		119,162	98,176	99,738
負債總額		1,401,422	1,860,981	2,076,664



最近年度財務分析

項目	年度	110年	111年	112年上半年
負債佔資產比(%)		36.48	40.23	44.04
流動比率(%)		245.32	226.48	207.46
存貨周轉率(次)		1.91	1.91	1.73
權益報酬率(%)		14.32	22.76	12.70

04

製造管理處

自製設備產品介紹與展望





實用新案登録証
CERTIFICATE OF UTILITY MODEL REGISTRATION

登録第 3 2 4 2 4 6 2 号
(REGISTRATION NUMBER)

考案の名称 (TITLE OF THE DEVICE) 回路基板製造プロセス用の熱交換システム

實用新案権者 (OWNER OF THE UTILITY MODEL RIGHT) 台湾台北市信義區松德路171號17樓
国籍・地域 台湾
揚博科技股ふん有限公司

考案者 (CREATOR OF DEVICE) 蘇 勝義
巫 坤星
呂 理榕

出願番号 (APPLICATION NUMBER) 実願2023-001284 その他紙記載

出願日 (FILING DATE) 令和 5年 4月 17日 (April 17, 2023)

登録日 (REGISTRATION DATE) 令和 5年 6月 12日 (June 12, 2023)

この考案は、登録するものと確定し、實用新案原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE UTILITY MODEL IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

令和 5年 6月 12日 (June 12, 2023)

特許庁長官 (COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE) 濱野 幸一

证书号第 17480510 号

实用新型专利证书

实用新型名称: 电路板制程的热交换系统

发明人: 苏胜义; 巫坤星; 吕理榕; 苏绍君; 钟添达; 杨延鸿

专利号: ZL 2022 2 1538110.X

专利申请日: 2022年06月20日

专利权人: 扬博科技股份有限公司

地址: 中国台湾台北市

授权公告日: 2022年09月27日 授权公告号: CN 217509142 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记, 专利权自授权公告之日起生效, 专利权期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

中華民國專利證書

新型第 M634845 號

新型名稱: 電路板製程的熱交換系統

專利權人: 揚博科技股份有限公司

新型創作人: 蘇勝義、巫坤星、呂理榕、蘇紹君、鍾添達、楊延鴻

專利權期間: 自 2022 年 12 月 1 日至 2032 年 6 月 15 日止

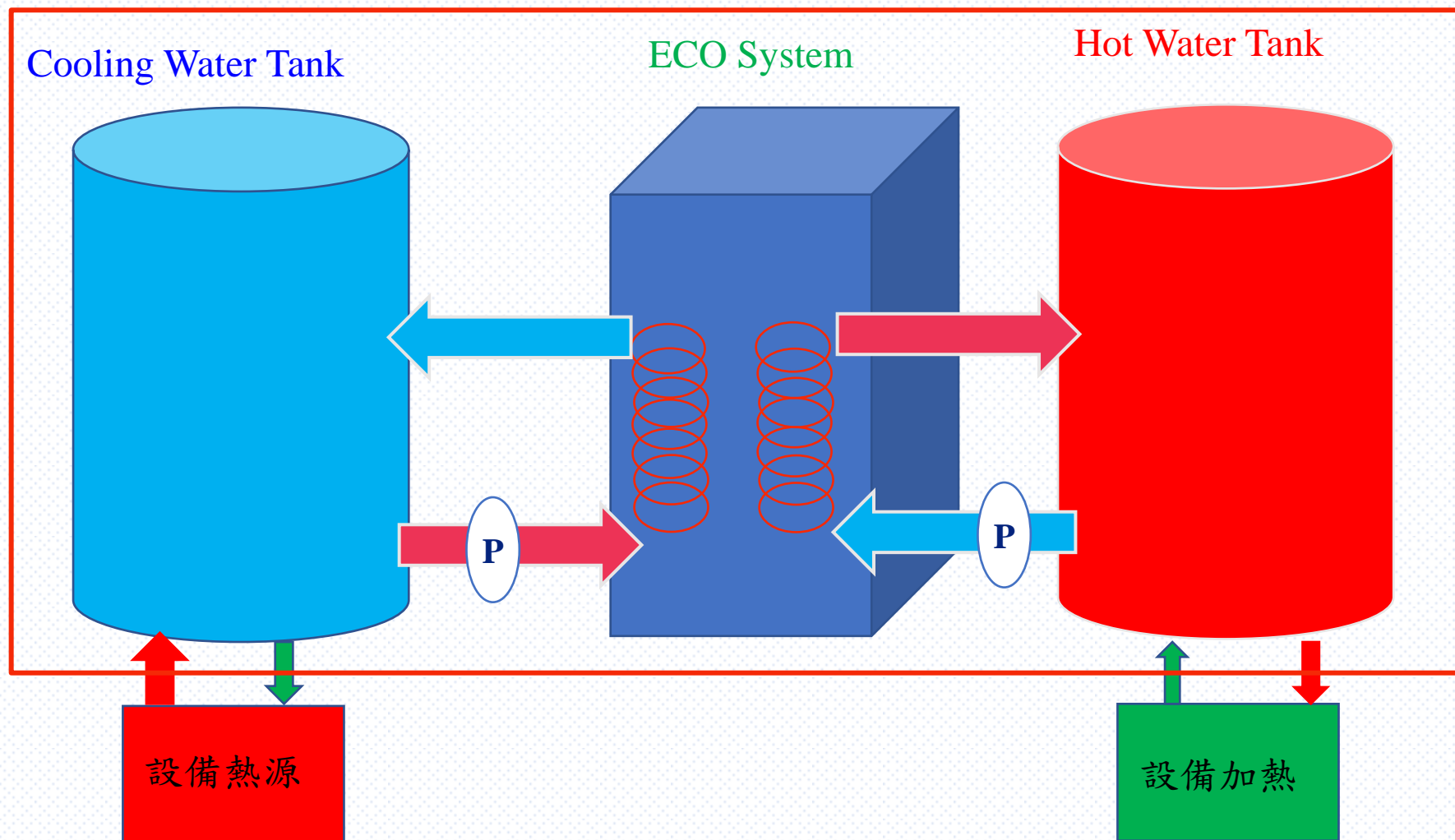
上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局局長 洪淑敏

中華民國 111 年 12 月 1 日

注意: 專利權人未依法繳納年費者, 其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。

ECO System 熱交換器示意圖





- 一、2023年上半年主要自製設備用途主要以載板及HDI、類載板佔比較高，應用市場包含智慧型手機、汽車電子、伺服器...等產品市場。
- 二、今年正式推出Ampoc 5A (Arrows)專利新產品，並將於今年TPCA公開發表，其中ECO 熱回收系統這項專利設計，對因應地球暖化節能的趨勢，客戶的節能減碳是有很大的貢獻。
- 三、未來設備研發與需求展望：
 - 1.ABF載板高階製程設備需求。
 - 2.各PCB廠跨入高階產品競爭，包括5G相關載板、類載板、HDI、軟板設備需求。
 - 3.電動汽車與安全相關PCB設備需求。
 - 4.節能減廢設備持續研發。

05

營業管理處

代理業務產業應用與產品介紹



先進封裝設備/材料/檢測解決方案





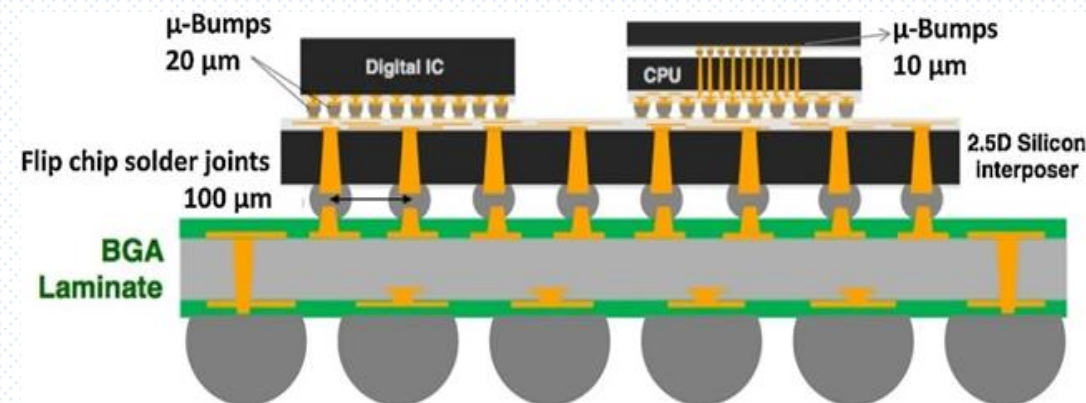
材料

◎ 先進製程封裝

- ➔ Micro Bumping/SnAg(目前已提供客戶量產)
- ➔ Cu Pillar(目前已提供客戶量產)
- ➔ Dielectric(開發中)

◎ 半導體前段材料

- ➔ 黃光材料(Lithograph material)
- ➔ 海內外市場半導體廠測試中



2.5D/3D IC 封裝結構的橫截面圖

資料來源: <https://www.eettaiwan.com/20221220nt41-3d-ic-ma-tek/>

設備

◎ AI/5G

- ➔ 2.5D Bonder(客戶驗證中)
- ➔ 3D Bonder(終端客戶產品最終驗證中)

製程應用

- ➔ Chip On Wafer on Substrate
 - ➔ HPC
 - ➔ 矽光子
- } AI



感謝聆聽
Thank you!